

【原因・判断ポイント・発生工程】板面に砥粒粉、薬液などが付着して、DFRの密着を阻害して出来たもの（DFRラミネート前～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】板面残留的研磨粉、药液等影响DFR的压合而引起的（DFR压合前～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Close adhesion of dry film is prevented by abrasive materials, chemical solution, etc. and the defect remains on a base material surface. (Dry film lamination – etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50

1-2-2-9 基準マーク欠け／基准标记的缺口 / Nick of fiducial mark

【特徴】基基準マーク部のシャープな欠け、あるいは基準マーク全体が無くなっている状態

【特征】基准标记部位有锐利的缺陷、或者基准标记整体流失。

【Characteristics】A fiducial mark is Clear cut partially or totally lost.

【原因・判断ポイント・発生工程】基準マーク部のDFRより上に不透明な異物が介在し露光を遮った為に出来たもの（露光焼付～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】在DFR的基准标记部位夹杂不透明杂物，妨碍曝光而引起的（曝光～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
An opaque foreign object above dry film on a fiducial mark area blocks the exposure light. (Imaging - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
基準マークが流失している
顕微鏡倍率×

【注釋】
基准标记流失
显微镜倍率 ×

【Comments】
FFiducial mark totally lost.
Magnification: ×